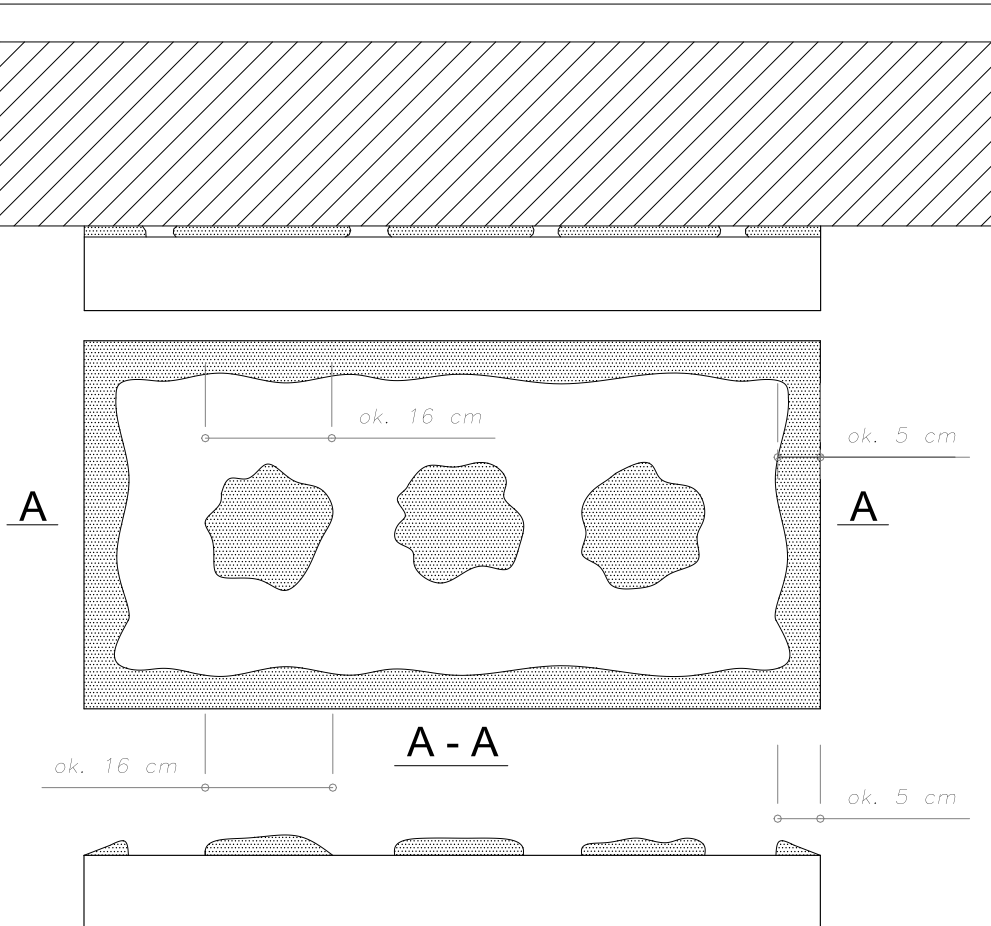


Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% \geq 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża
P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej.

Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNICY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM	
PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA -
DETAL KLEJENIA PŁYT	BRANZA: ARCHITEKTURA
DANE INWESTORA: Gmina Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26 32-700 Bochnia	NR RYSUNKU: AD5
ADRES BUDOWY: Brzeźnica 180 DZ. NR 388/1 i 388/2	GRUDZIEŃ 2020
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86 Spec. Architektoniczna	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Bartłomiej Zdanowski	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Agnieszka Szulc 46/SLOKK/2016/II Spec. Architektoniczna	PODPIS:
Pracownia Projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl	